

KOSDAQ | 반도체와반도체장비

싸이맥스 (160980)

전공정 재개, 후공정은 지속

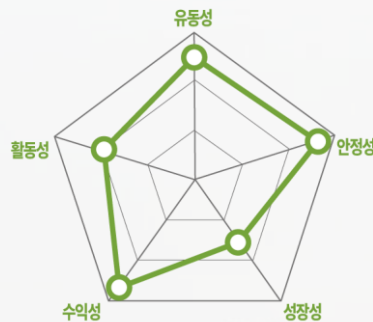
체크포인트

- 반도체 웨이퍼 이송장비(CTS-EFEM-LPM) 전문업체. 삼성전자 EFEM 표준화 공급사로 선정되어 있어 메모리 CAPA 투자 확대가 곧 수주 증가로 직결되는 구조
- 2026년 삼성전자 P4, SK하이닉스 M15X 전공정 투자 본격화와 하반기 HBM 후공정 투자 가세로 전공정 및 후공정 동반 수혜 구간 진입. 차세대 제품(VFEM-Slim EFEM-EDM)을 통한 해외 장비사 신규 진입은 중장기 성장동력으로 기대
- 2026F 매출 2,321억원(+41.1% YoY), 영업이익 356억원(+52.7% YoY), OPM 15.4% 전망. 매출 레버리지와 후공정 믹스 개선이 수익성 개선을 견인

주가 및 주요이벤트

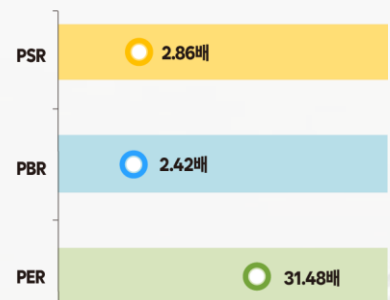


재무지표



주: 2025년 기준, Fnguide WICS 분류상 IT산업 내 등급화

밸류에이션 지표



주: PSR, PBR은 2025년 기준, PBR은 1Q26 기준, Fnguide WICS 분류상 IT산업 내 순위 비교, 우측으로 갈수록 저평가

싸이맥스 (160980)

Analyst 박성순 sspark@kirs.or.kr

RA 김지은 jekim0216@kirs.or.kr

KOSDAQ

반도체와반도체장비

웨이퍼 이송장비 업체

동사는 반도체 전공정 및 후공정 웨이퍼 이송장비 업체. 주요 생산 품목은 CTS(Cluster Tool System), EFEM(Equipment Front End Module), LPM(Load Port Module)으로 구성. 2025년 기준 매출 비중은 국내 85%, 수출 15%를 기록

메모리 투자 수혜 기대

반도체 고객사들의 CAPA 확대에 따른 동사 장비 수요 증가가 예상. 동사는 국내 메모리 업체와 미국, 중국 DRAM 업체, Foundry 및 OSAT 업체로 장비를 공급. 최종 고객사 기준으로 보면 국내 메모리 업체향 매출 비중은 약 70~80%에 달함. 따라서 메모리 투자가 실적에 가장 큰 영향을 끼침. 동사는 삼성전자의 EFEM 표준화 공급사로 선정되어 있어 고객사 EFEM 공급 물량 내에서 높은 점유율을 보이고 있는 만큼 삼성전자의 신규 Fab 투자와 함께 동사 수주도 함께 증가. 향후에는 VFEM, 제습모듈, Slim EFEM 등 차세대 제품을 통해 고객사 확대를 이룰 것으로 기대

매출과 수익성 개선 기대되는 2026년

2026년 매출액 2,321억원(+41.1% YoY), 영업이익 356억원(+52.7% YoY)을 전망. 2026년 고객사의 투자로 인해 전공정향 장비 매출 성장이 예상. 하반기에는 HBM향 후공정 투자가 더해질 것으로 전망. 수익성 측면에서는 매출액 규모가 확대됨에 따른 이익률 개선이 예상. 또한 후공정 장비의 경우 ATM 로봇 내재화와 EFEM의 포트 수가 많아 단가와 수익성이 전공정 장비 대비 높음. 2026F OPM 15.4%(+1.2%p YoY)를 전망

Forecast earnings & Valuation

	2022	2023	2024	2025	2026F
매출액(억원)	1,951	1,566	1,651	1,644	2,321
YoY(%)	-19.5	-19.7	5.4	-0.4	41.1
영업이익(억원)	212	71	234	233	356
OP 마진(%)	10.8	4.5	14.2	14.2	15.4
지배주주순이익(억원)	76	110	154	149	260
EPS(원)	699	1,008	1,411	1,368	2,382
YoY(%)	-68.7	44.2	39.9	-3.1	74.2
PER(배)	16.6	14.3	6.0	10.7	15.6
PSR(배)	0.6	1.0	0.6	1.0	1.7
EV/EBITDA(배)	3.8	10.6	2.2	2.5	8.1
PBR(배)	0.8	1.0	0.5	0.8	1.9
ROE(%)	5.1	7.0	9.2	8.1	12.7
배당수익률(%)	2.6	2.4	4.1	2.7	1.1

자료: 한국IR협의회 기업리서치센터

Company Data

현재가(07/06)	36,300원
52주 최고가	46,500원
52주 최저가	11,820원
KOSDAQ(07/06)	84707p
자본금	55억원
시가총액	3,966억원
액면가	500원
발행주식수	11백만주
평균거래량(60일)	24만주
평균거래대금(60일)	85억원
외국인지분율	2.59%
주요주주	인지컨트롤스 외 5인 47.39%

Price & Relative Performance



Stock Data

주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	0.8	125.7	174.2
상대주가	19.3	154.8	151.1

참고

1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 '부채비율', 성장성 지표는 'EPS증가율', 수익성 지표는 '영업이익률', 활동성지표는 '총자산회전율', 유동성지표는 '유동비율'임. 2) 표지 밸류에이션 지표 차트는 해당 산업군내 동사의 상대적 밸류에이션 수준을 표시. 우측으로 갈수록 밸류에이션 매력도 높음.



기업 개요

❏ 싸이맥스는 반도체 웨이퍼 이송장비 전문 기업

2005년 설립되어

2015년 코스닥 상장한

반도체 웨이퍼 이송장비

전문 기업

싸이맥스는 2005년 12월 반도체 관련장비 및 산업용 로봇의 제조·판매를 목적으로 설립된 반도체 웨이퍼 이송장비 전문기업이다. 동사는 브룩스오토메이션 한국지사장 출신의 김성강 대표가 신성엔지니어링 등의 투자를 받아 창업한 회사로, 설립 초기부터 미국에 브룩스오토메이션·PRI오토메이션 출신 연구진으로 구성된 현지법인을 두는 등 한·미·일 연구개발 체제를 갖추었다. 설립 직후인 2006년 로봇 연구개발을 담당하는 미국 현지법인과 기업부설연구소를 설립하고 벤처기업 인증을 취득하였으며, 2008년 하이닉스반도체 협력업체로 등록되고 삼성전자 EFEM 표준화 업체로 선정된 데 이어 2009년에는 삼성전자 협력업체로 등록되며 주요 메모리 고객사와의 거래 기반을 확보하였다. 한편 동사는 2009년 6월 최대주주가 (주)디네트웍스에서 (주)인지컨트롤스로 변경되면서 자동차 부품 기업인 인지컨트롤스 기업 집단에 편입되었으며, 2015년 6월 한국거래소 코스닥시장에 상장하였다.

사업 전개 측면에서는 설립 초기 FOUP 도어를 개폐하는 로드포트모듈 LPM과 대기 중 웨이퍼를 반송하는 EFEM을 기반으로 사업을 시작하였다. 외국계 업체가 주도하던 반도체 웨이퍼 이송장비 시장에서, 설립 1년여 만에 클러스터 톨 시스템 CTS와 EFEM, 진공로봇 등 핵심 장비를 국산화하며 국내 주요 공급사로 성장했다. 2007년에는 LPM 전용 브랜드 'Duraport' 상표 등록과 생산라인 준공에 더해 6각 진공 트랜스퍼 모듈 TM을 처음 선보이며 대기로봇·진공로봇·얼라이너를 아우르는 클러스터 톨 시스템의 일괄 공급 체계를 갖추었고, 이후 4각 Twin-In-Line 타입과 8각 TM 등으로 제품 라인업을 넓혔다. 또한 2008년 삼성전자 EFEM 표준화 업체 선정 및 같은 해 450mm 대구경 웨이퍼 이송장치 정부 과제 업체 선정을 계기로 차세대 이송장비 개발 역량을 축적해 2013년 해당 장치 개발을 완료하였다. 적용 영역 또한 전공정 EFEM에서 출발해 FoPLP, TSV, 검사·계측 등 후공정 영역으로 점차 확대되어 왔다.

대외적으로는 2011년 300만불을 시작으로 2012년 500만불, 2014년 1,000만불 수출의 탑을 연이어 수상하며 수출 기반을 넓혀 왔다. 또한 2017년 유·무상증자를 통해 자본금을 27.2억원에서 52.9억원으로 확충하고 안성과 화성 동탄 생산시설을 증설하는 등 생산능력을 지속적으로 늘려 왔으며, 2020년 2월 (주)사이로그랩을 흡수합병하고 2021년 4월 중소기업에서 중견기업으로 전환되었다. 현재는 경기도 화성시 동탄에 본사와 주력 생산시설을 두고 있다.

싸이맥스 연혁

2005~2010	2011~2016	2017~
2005. 12 (주)싸이맥스 설립 (설립자본금 140백만원) 2006. 03 (주)싸이맥스 미국현지법인 설립 (Robot R&D Center) 2006. 04 품질경영시스템 ISO 9001 인증 획득 2006. 05 기업부설연구소 설립 (한국산업기술진흥협회) 2006. 06 벤처기업 등록 (기술신용보증기금) 2006. 06 환경경영시스템 ISO 14001 인증 획득 2007. 02 LPM 제품 <Duraport> 상표 등록 2007. 03 LPM 생산라인 준공 2007. 03 싸이맥스/CYMECHS 상표 등록 2008. 06 하이닉스 반도체 협력업체 등록 2008. 07 450mm 대구경 웨이퍼 이송장치 정부과제 업체 선정 2008. 08 삼성전자(주) EFEM 표준화 업체 선정 2009. 02 기술혁신형 중소기업 INNO-BIZ(이노비즈) 업체 선정 2009. 03 지식경제부 주관 부분소재전문기업 인증 획득 2009. 10 삼성전자(주) 협력업체 등록 2010. 03 삼성전자(주) 생산기술연구소 협력업체 등록 2010. 04 병역특례업체 지정 2010. 05 수원 영통 고객지원센터 (CS Center) Open	2011. 03 안성 2공장 증설 (소재자: 경기도 안성시 공도읍 용두리 453번지 나동) 2011. 11 300만불 수출의 탑 수상 2012. 09 지식경제부 생산성향상 우수기업 지정 2012. 12 500만불 수출의 탑 수상 2013. 04 450mm 대구경 웨이퍼 이송장치 개발 완료 2014. 12 1,000만불 수출의 탑 수상 2015. 01 「고객감동경영 5170」 선포 2015. 02 정보보안경영시스템 ISO 27001 인증 획득 2015. 06 한국가레스 코스닥시장 상장 2015. 12 2015년 하반기 경기도 일자리 우수기업 인증 획득 2016. 02 원익IPS 우수협력사상 수상 2016. 04 2016년 고용노동부 청년 친화 강소기업 인증 획득 2016. 05 삼성전자 동반성장 협력상 수상 2016. 06 2016년 글로벌강소기업 지정 (중소기업청) 2016. 07 동탄공장 신설 (소재자: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47)	2017. 07 전북기계공업고등학교(마이스터고) 산학협력협약 체결 2017. 09 2공장 증설 (소재자: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단10길 46) 2017. 10 유.무상증자 (변경전 자본금 2,715백만원 → 변경후 자본금 5,288백만원) 2017. 12 2017 Annual Achievement Award 선정(세메스) 2017. 12 청년친화기업 선정 (고용노동부) 2018. 05 중소벤처기업부 장관상 수상 2018. 06 코스닥협회 최우수 차세대 기업상 수상 2018. 11 일하기 좋은 기업 선정 (대한상공회의소, 한국고용정보원, 잡플래닛) 2019. 01 2019 청년친화강소기업 선정 (고용노동부) 2020. 02 (주)사이보그랩 흡수합병 2020. 11 혁신기업 국가대표 1000 선정 2021. 06 주식회사 원익아이피에스 우수협력사 수상 2021. 12 삼성전자 2021 Outstanding vendor award 수상 2022. 01 삼성전자 2022 Outstanding vendor award 수상 (2년 연속) 2022. 04 안전보건경영시스템 ISO-45001 인증 획득 2022. 05 SEMES 최우수협력사 선정 2022. 06 싸이맥스 신규시설투자 증설 완료 2022. 12 TES 최우수협력사 선정 2023. 11 SEMES 우수협력사 선정 2023. 12 TES 생산관리상 수상 2024. 12 TES 협력사 Awards 금상 수상 2025. 12 TES 협력사 Awards 금상 수상

자료: 싸이맥스, 한국IR협의회 기업리서치센터

종속회사 현황

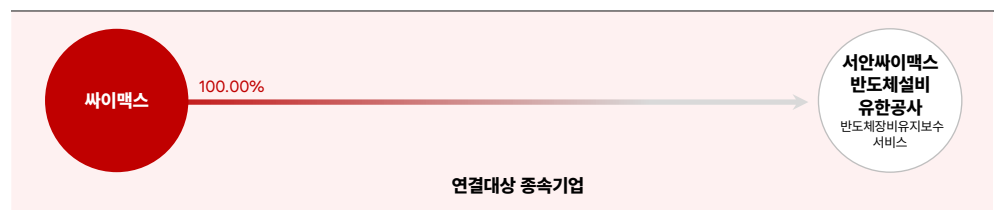
2026년 1분기 말 기준

연결대상 종속회사

1개사 보유

싸이맥스는 2026년 1분기 말 기준 총 1개의 비상장 종속회사를 연결대상으로 보유하고 있다. 유일한 연결대상 종속회사인 서안싸이맥스반도체설비유한공사는 2015년 4월 설립자본금 30만위안으로 설립된 중국 시안 소재 법인으로, 동사가 자본 100%를 보유하고 있다. 동 법인은 반도체 장비의 유지보수 서비스를 주된 사업으로 하며, 중국 내 고객사에 대한 설치·A/S 등 기술지원을 담당해 동사의 해외 고객 대응 거점 역할을 수행하고 있다.

싸이맥스 지분도



주: 2026년 3월말 기준, 자료: Dart, 한국IR협의회 기업리서치센터

주요 사업 및 매출 구성

반도체 웨이퍼 이송장비를 포함하는 반도체 장비 단일 사업부문 구조

동사의 사업은 반도체 웨이퍼 이송장비를 포함하는 반도체 장비 단일 사업부문 구조를 보인다. 주요 생산 품목은 CTS(Cluster Tool System), EFEM(Equipment Front End Module), LPM(Load Port Module)으로 구성되어 있다. 2025년 기준 매출 비중은 국내 85%, 수출 15%를 기록하였다.

CTS (Cluster Tool System)

반도체 공정 장비(Process Module)와 연결되는 웨이퍼(Wafer) 이송 장비이며, OHT(Overhead Hoist Transport)에 반송된 FOUP(Front Opening Unified Pod)의 내부 웨이퍼를 공정 장비까지 이송하는 Tool Automation 장비이다. 주요 구성 모듈은 EFEM, Load Lock Chamber, VTM(Vacuum Transfer Module) 세 블록이며, 이 중 EFEM은 LPM(Load Port Module), 대기 로봇(ATM Robot), Aligner로 구성되고 VTM은 진공 로봇(VTM Robot)을 내재한다. EFEM은 대기압 환경에서 동작하는 전단부 모듈로 FOUP에서 웨이퍼를 꺼내 정렬하고, 다음 단계로 넘기기까지의 구간을 담당한다. Load Lock Chamber (LLC)는 EFEM(대기)과 VTM(진공) 사이의 환경 전환 공간으로 웨이퍼를 받은 뒤 도어를 닫고 내부를 진공 펌핑(또는 공정 가스로 치환)해서, 대기 환경과 진공 환경이 직접 섞이지 않게 격리하는 역할을 한다. VTM은 진공 환경에서 동작하는 이송 모듈로 내부의 VTM Robot이 로드락에서 받은 웨이퍼를 주변에 방사형으로 배치된 여러 Process Module로 분배한다. 고객사의 요구사항 및 공정 장비 특성에 따라 VTM의 다각형 (4각·5각·6각·8각) 구성과 Process Module 연결 개수가 달라지며, 이는 장비당 처리량(Throughput)과 직결된다. Cluster Tool은 이처럼 공정 장비의 특성을 고려하여 고객의 요구사항에 맞는 맞춤형 System으로 구성한다.

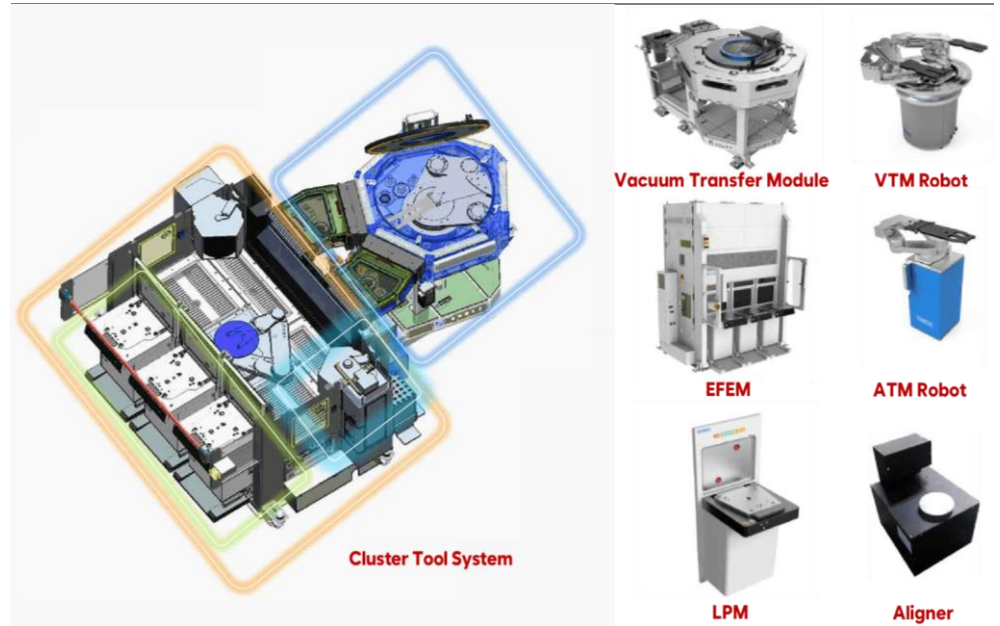
EFEM (Equipment Front End Module)

EFEM은 대기 상태에서 웨이퍼를 반송하는 반도체 전공정 인터페이스 모듈로 LPM, ATM 로봇, Aligner, EFEM Software로 구성되어 있으며 내부 고청정도 유지를 위한 FFU(Fan Filter Unit)가 적용되어 있다. LPM은 FOUP을 도킹하고 도어를 개폐해 웨이퍼를 꺼내는 부분이다. ATM 로봇은 웨이퍼를 FOUP - Aligner - Load Lock 사이로 이송하는 로봇이다. Aligner는 웨이퍼의 노치/플랫존 위치와 센터를 맞춰 다음 공정에서 정확한 포지셔닝을 가능하게 한다. FFU는 HEPA/ULPA 필터를 통해 EFEM 내부의 파티클 발생을 억제한다.

LPM (Load Port Module)

LPM은 반도체 제조용 웨이퍼를 담아두는 FOUP 도어를 열거나 닫으면서 웨이퍼가 반송될 수 있도록 해주는 독립 모듈이다. 구동은 Stage-Door Trans-Z-Axis 동작으로 이루어지며, FOUP 도어를 개방하면서 동시에 내부 웨이퍼 정보 (개수, 들어짐, 겹침)를 확인하는 매핑(Mapping)을 수행한다. 미세 들어짐까지 감지할 수 있는 고정밀 매핑 기능을 갖추고 있으며, FOUP 내부의 O₂-H₂O로 인한 반도체 수율 저하를 방지하기 위해 습도를 저감하는 N₂ Purge LPM도 적용되고 있다.

싸이맥스 장비



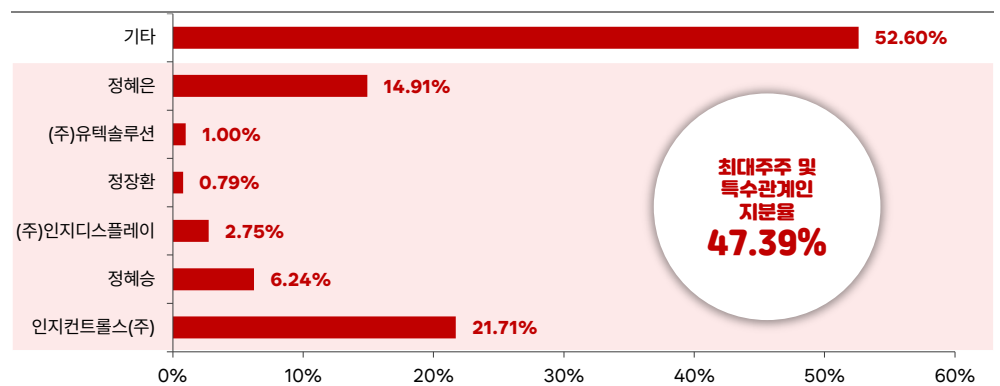
자료: 싸이맥스, 한국IR협회의 기업리서치센터

주주 구성

인지컨트롤스(주)는
싸이맥스의 최대주주로 1Q26말
기준 지분을 21.71% 보유

싸이맥스의 최대주주는 인지컨트롤스(주)로, 1Q26 말 기준 지분 21.71%를 보유하고 있다. 인지컨트롤스(주)는 1978년 1월 31일에 자동차부품 제조 및 판매를 사업목적으로 설립되었으며, 1997년 6월 23일자로 코스피에 상장했다(7/3 기준 시가총액 914억 원). 현재는 국내외의 완성차 업체에 부품을 제조하여 판매하고 있으며, TMS(엔진 온도관리 시스템 부품), EMS(엔진 온도, 진동, 압력 등 측정 및 신호 전달을 위한 센서 및 스위치 부품), EP(엔지니어링 플라스틱 경량화 부품), 친환경부품 등이 주요 제품군이다. 2026년 3월말 기준, 자산총액은 7,073억 원, 당기순이익은 65억 원이다.

싸이맥스 주주 현황



주: 2026년 3월말 기준, 자료: Dart, 한국IR협회의 기업리서치센터



산업 현황

1 글로벌 EFEM 및 Sorters 시장

**글로벌 EFEM 및 Sorters 시장
규모는 2026년 약 41.9억
달러로 추정**

글로벌 EFEM 및 Sorters 시장 규모는 2026년 약 41.9억 달러로 추정되며 2024~2033년 CAGR 8.54%로 성장이 전망된다. AI 반도체 수요 확대에 따른 글로벌 Fab 투자 사이클 진입이 핵심 성장 요인이다. 시장은 Rorze, Brooks Automation 두 업체가 전체의 60% 이상을 점유하고 있으며, 일본이 전체 생산의 40%를 담당하는 최대 생산 지역이다. 제품 유형별로는 3-PORT EFEM이 약 50%로 최대 비중을 차지하고, 300mm 웨이퍼 적용 제품이 95%를 점유한다.

Rorze(일본)는 글로벌 EFEM 시장의 지배적 1위 업체로 FY2026 반도체 부문 매출 가이드는 1,324.8억엔(약 8.3억 달러, +24.6% YoY)이다. 반도체 매출 비중이 전체의 83% 이상으로 사업 순수성이 높고, EFEM 외에도 Aligner, Load Port, ATM Robot, Vacuum Platform, Wafer Sorter, N2 Purge Wafer Stocker 등 반도체 이송 시스템 전제품을 공급하는 풀라인업을 보유한다. OPM 24% 수준의 높은 수익성을 유지하고 있으며, TSMC, 삼성전자, SK하이닉스, Micron, Intel 등 특정 고객사에 의존하지 않는 넓은 글로벌 고객 기반이 경쟁 우위의 핵심이다. 최근에는 어드밴스드 패키징 시장 확대에 대응해 Tape Frame Sorter와 PLP EFEM을 신제품으로 개발하며 Middle-end 시장으로 적용 범위를 확대하고 있다.

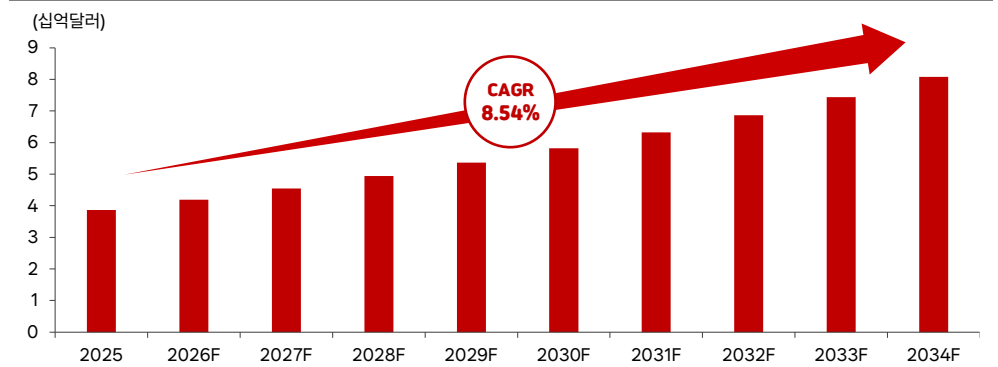
Brooks Automation(미국)은 40년 이상의 업력을 보유한 반도체 웨이퍼 핸들링 시스템 전문업체로 EFEM, Load Port, 진공 로봇, 오염 제어 솔루션 등 웨이퍼 이송 시스템 풀라인업을 공급한다. 2022년 사모펀드 THL에 인수되며 비상장 전환됐고 현재는 재무 데이터가 공개되지 않는다. 다만 2021년 매각 당시 반도체 자동화 사업부 매출이 약 6.1억 달러 수준이었다는 점에서 Rorze와 함께 글로벌 웨이퍼 이송 장비 시장의 양대 축을 형성하고 있는 것으로 파악된다.

Hirata(일본)는 웨이퍼 이송 장비 외에도 자동차 관련 생산 설비를 주력으로 하는 복합 자동화 장비 업체다. FY2025 기준 반도체 부문 매출은 361억엔(+19.6% YoY)으로 전체 매출 949억엔의 38%를 차지하며, 자동차 부문(435억엔, 46%)이 여전히 최대 세그먼트다. 반도체 부문 OPM이 6.7%에 그쳐 자동차 부문 11.8%에 비해 수익성이 낮다. FY2026 반도체 부문 매출 가이드는 460억엔(+27.4% YoY)으로 AI 수요 확대에 따른 수주 증가를 반영하고 있으며, 생산능력을 FY2024 대비 50% 확대하는 것을 목표로 하고 있다. 전공정 웨이퍼 이송 장비 외에 PLP(Panels Level Packaging)용 EFEM, Load Port, 이송 로봇을 차세대 성장 영역으로 집중 육성 중이다.

국내에서는 싸이맥스, 로체시스템즈, 라온로보틱스가 주요 공급사로 경쟁하고 있다. 로체시스템즈는 Rorze의 자회사로 기술, 고객 네트워크에서 글로벌 레퍼런스를 보유하고 있으나 디스플레이 매출 비중이 높아 반도체 순수성 측면에서 약점이 있다. 라온로보틱스는 진공 로봇 전문사로 VTM Robot 양산 업체이며, 중국 NAURA향 공급을 계기로 해외 고객 확대를 추진하고 있다.

구조적 시장 성장 트렌드로는 두 가지가 주목된다. 첫째, N2 퍼지 및 제습모듈 수요 확대다. 미세공정화에 따라 EFEM 내부 습도 및 산소 제어 요구 수준이 높아지면서, 기존 N2 가스 충전 방식을 넘어 로터 기반 제습모듈(EDM) 등 고부가 사양 제품의 채택이 확대되고 있다. 둘째, 어드밴스드 패키징용 EFEM 적용 확대다. HBM, CoWoS, PLP 등 첨단 패키징 공정이 확대되면서 후공정 장비에도 EFEM 탑재가 표준화되는 추세이며, Rorze와 Hirata 모두 PLP EFEM을 차세대 성장 영역으로 주목하고 있다.

글로벌 EFEM 및 Sorters 시장 규모



자료: Precedence Research, 한국IR협회의 기업리서치센터

글로벌 반도체 장비 시장 전망

**글로벌 300mm 펌 장비
투자액은 2026년 1,330억
달러(+18% YoY), 2027년
1,510억 달러(+14% YoY)에
이를 것으로 전망**

전 세계 300mm 펌 장비 투자액이 2026년에는 18% 증가한 1,330억 달러, 2027년에는 14% 증가한 1,510억 달러에 이를 것으로 전망된다. 이는 데이터 센터 및 엣지 디바이스용 AI 칩 수요 급증과 주요 지역에서 현지화된 산업 생태계 및 공급망 재편을 통해 반도체 자급자족을 강화하려는 움직임에 기인한다. 2028년에는 3% 증가한 1,550억 달러, 2029년에는 11% 증가한 1,720억 달러에 이를 것으로 전망된다.

로직 및 마이크로컴포넌트 부문은 2027년부터 2029년까지 총 2,280억 달러의 투자를 통해 장비 확장을 주도할 것으로 예상된다. 주로 2nm 이하의 최첨단 설비 투자로 파운드리 부문이 강력한 수요를 견인할 것이다. 첨단 노드 기술은 다양한 AI 애플리케이션의 까다로운 칩 설계 요구 사항을 충족하기 위해 칩 성능과 전력 효율을 향상시키는 데 필수적이다. 더욱 발전된 노드 기술은 2027년부터 2029년 사이에 양산 단계에 진입할 것으로 예상된다. AI 성능 향상은 다양한 엣지 AI 기기의 폭발적인 성장을 견인하고, 첨단 노드 기술 외에도 모든 노드 및 다양한 전자 기기에 대한 수요는 완만하게 증가할 것으로 예상되어 기존 노드 기술에 대한 투자도 이어질 것으로 보인다.

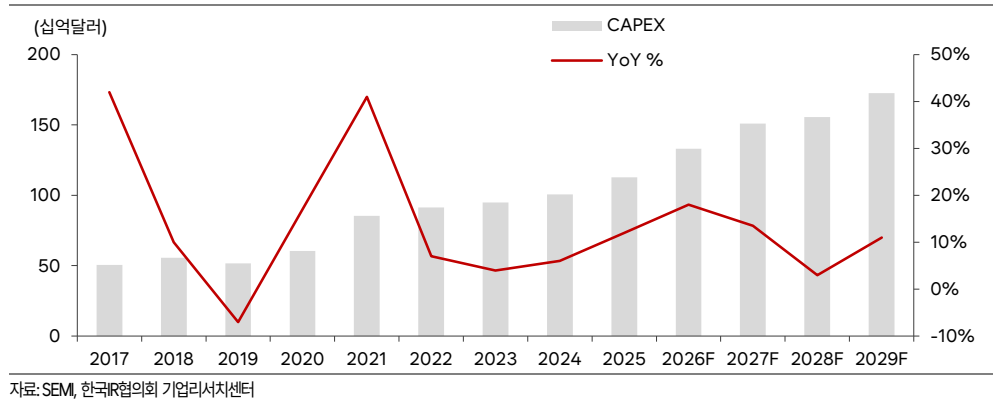
메모리 부문은 2026년 +9% 증가한 520억 달러에 도달한 후 2027년에는 11% 증가한 570억 달러에 이를 것으로 전망된다. AI 인프라, 데이터 센터 및 차세대 컴퓨팅 시스템에 대한 투자 증가에 힘입어 AI 기반의 첨단 메모리 수요가 지속적으로 증가함에 기인한다. 메모리 부문의 전 세계 300mm 펌 장비 투자액은 2024년부터 2029년까지 연평균 19% 성장할 것으로 예상된다. 세계 300mm 메모리 생산 능력 또한 증가하여 2026년에는 월 410만 웨이퍼, 2027년에는 월 420만 웨이퍼에 이를 것으로 전망된다. HBM 및 첨단 메모리 기술에 대한 강력한 수요로 인해 반도체 공급망 전반에 걸쳐 투자 우선순위가 재편되고 있다. AI 인프라가 확장됨에 따라 메모리 제조업체들은 차세대 데이터 집약

적 애플리케이션을 지원하기 위해 생산 능력 확대와 기술 이전 투자를 가속화하고 있다.

DRAM 장비 투자는 GPU 및 기타 AI 가속기에 사용되는 HBM 및 DDR5 수요 증가에 힘입어 2026년까지 29% 증가한 370억 달러에 이를 것으로 예상된다. 3D NAND 장비 투자 또한 AI 배포와 관련된 데이터 저장 요구 사항 증가에 따라 2026년까지 28% 증가한 140억 달러에 이를 것으로 보인다. 첨단 노드 DRAM 및 고층 3D NAND에 대한 지속적인 투자는 메모리 용량 전망을 강화하고 있다. 그러나 첨단 노드 DRAM, HBM 및 고층 NAND로의 전환을 포함한 기술 마이그레이션 및 공정 복잡성으로 인해 실질적인 용량 증가는 여전히 제한적이다.

지역별로 중국에서는 지속적인 국내 생산 능력 확장과 반도체 제조 역량 강화를 위한 국가적 정책에 힘입어 투자가 꾸준히 이어질 것으로 예상된다. 대만 지역에서는 2nm 이하 기술을 포함한 최첨단 파운드리 설비 확충이 투자 성장을 주도할 것으로 전망된다. 한국은 AI 관련 수요 증가로 CAPA 확대 및 테크 마이그레이션이 메모리 부문에 집중될 전망이다. 미국은 첨단 공정 확장과 국내 제조 생태계 강화로 투자가 증가할 것으로 예상된다.

글로벌 300mm Fab 장비 투자액 전망



글로벌 반도체 시장 전망

**2026년 글로벌 반도체 시장은
메모리 부문의 주도로 인해
+102.0% YoY 증가한
1.59조 달러 전망**

2026년 글로벌 반도체 시장은 2025년 7,903억 달러에서 +102.0% YoY 증가한 1.59조 달러가 전망된다. 급격한 성장세는 주로 메모리 부문에 의해 주도되고 있으며, 메모리 부문은 전년 대비 +295.8% 성장하여 8,893억 달러에 이를 것으로 예상된다. AI 인프라, HBM, 가속 컴퓨팅 플랫폼에 대한 지속적인 수요가 반도체 산업 성장의 주요 동력으로 작용하고 있다. 로직 부문 또한 2026년 37% 성장하며 주요 성장 동력으로 남을 것으로 전망된다. 미주 지역은 AI 관련 반도체 수요와 클라우드 인프라 투자 집중으로 인해 2026년까지 +112%의 성장률을 기록하며 두 배 이상 성장할 것으로 전망되고, 아시아 태평양 지역은 87%, 유럽과 일본은 각각 58%와 28%의 성장률을 보일 것으로 예상된다.

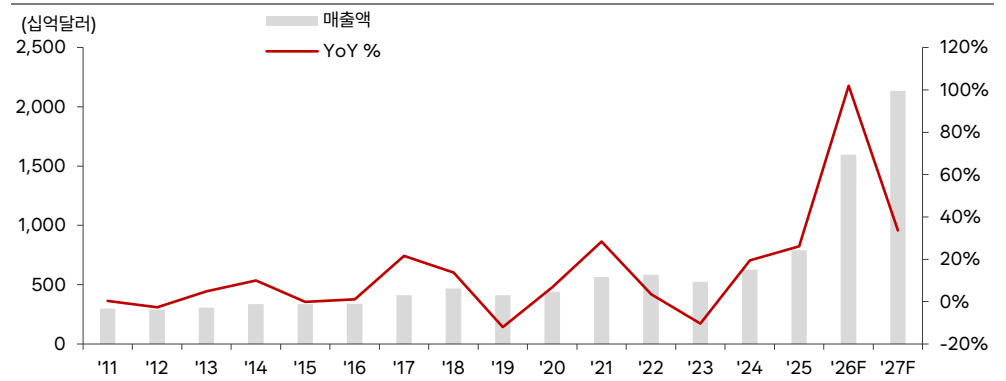
하이퍼스케일러와 대형 CSP들은 2026년까지 수천억 달러 규모의 자본 지출을 계획하며, GPU 최적화 서버 플랫폼에 대한 대규모 수요를 지속적으로 유지하고 있다. AI 인프라 도입은 더 이상 최대 규모의 퍼블릭 클라우드에만 국한되지 않는다. 국가 주도의 AI 컴퓨팅 인프라 구축 프로그램인 국가 AI 이니셔티브는 현재 40개국 이상으로 확대되어, 상업적 예산 주기와는 대체로 무관한 정책 주도형 수요를 창출하고 있다.

AI 애플리케이션이 LLM 학습에서 AI 추론으로 발전함에 따라 CSP 데이터 센터는 AI 전용 서버에서 범용 서버로 구축 우선순위를 전환하고 이러한 변화로 메모리 조달 수요는 HBM, LPDDR5X 및 고용량 RDIMM을 넘어 다양한 용량의 RDIMM 제품까지 확대되고 있다. DRAM 공급업체의 재고 수준은 극히 낮은 수준을 유지하고 있으며 AI 서버용 고용량 RDIMM의 공급 확대가 우선시되고 있다. 이로 인해 PC OEM 및 스마트폰 제조사의 제품 공급이 제한되고 일반 DRAM의 bit 출하량 증가는 당분간 제한적일 것으로 보인다. 가격 측면에서는 CSP들이 가격 인상을 수용하는 데 더 적극적이다. 이에 따라 다른 고객들도 공급 확보를 위해 가격 인상을 수용하고 있다. DRAM의 수급 불균형 심화로 2025년 하반기 이후 레거시 DRAM 가격의 급격한 상승이 일어났다. 향후 공급업체들은 HBM 가격 추이에 따라 HBM과 레거시 DRAM 간의 생산 allocation을 조정할 것으로 예상된다. 2026년 HBM 수요 증가는 주로 AI ASIC 용량 업그레이드로 인해 발생할 것으로 예상되며 칩당 HBM 용량이 96GB/192GB에서 216GB/288GB로 크게 증가할 전망이다. 2027년에는 NVIDIA의 Rubin Ultra 플랫폼이 GPU당 HBM 용량을 384GB까지 더욱 늘릴 것으로 예상된다. 상위 3개 공급업체의 HBM 웨이퍼 투입량이 2025년, 2026년, 2027년 말까지 전체 DRAM 웨이퍼 투입량의 약 18%, 22%, 30%를 각각 차지할 것으로 보이며 같은 기간 동안 HBM 비트 공급량은 전체 DRAM 비트 공급량의 각각 약 8%, 9%, 13%를 차지할 것으로 예상된다. 따라서 2027년에도 HBM 세대가 계속 발전하면서 다이 크기가 커지고 수요가 동시에 증가함에 따라 기존 DRAM 생산 능력에 대한 구축 효과는 더욱 심화될 것으로 예상된다. 공급업체에게 HBM 가격 인상을 위한 강력한 명분을 제공하고 내년 HBM 가격 협상에서 가격 결정력을 강화할 것으로 판단된다.

레거시 DRAM 공급의 구조적 경색으로 인해 소비자 DRAM 구매자들은 공급 확보를 위해 구형 메모리 제품을 채택하고 있다. 이는 구형 DRAM 부품 조달에 대한 새로운 수요를 촉발하여 DDR2 및 DDR3와 같은 구형 제품의 가격 상승세를 지속시키고 있다. 3대 DRAM 공급업체가 AI 인프라 투자로 인한 HBM 및 서버 DRAM 수요 증가에 대응하기 위해 첨단 노드 생산에 지속적으로 우선순위를 두고 있어 DDR4 및 기타 성숙 노드 제품의 웨이퍼 할당량이 감소하여 DDR4와 같은 소비자용 DRAM 구매자들이 대만 DRAM 공급업체로부터 공급을 받아야 하는 상황이다. 구형 DRAM 부품 조달에 대한 새로운 수요를 촉발하여 DDR2 및 DDR3와 같은 구형 제품의 가격 상승세를 지속시키고 있다. 결과적으로 소비자용 DRAM의 공급 부족 현상이 후속 기술 세대로 확산되고 있다.

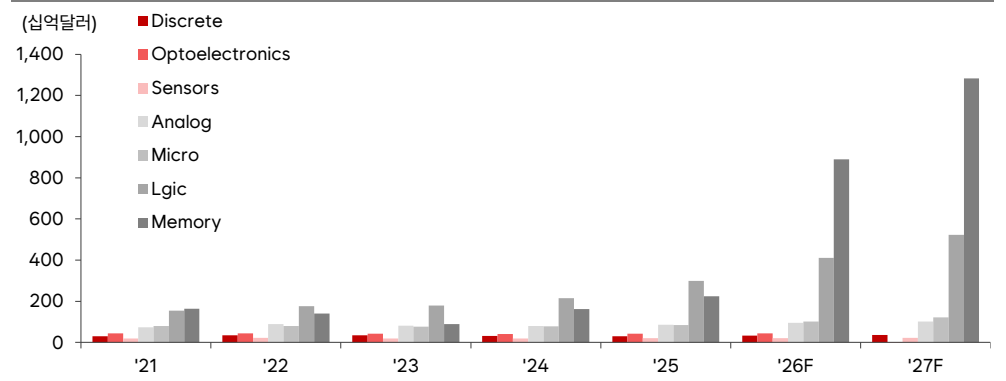
NAND 역시 메모리 비용 상승과 최종 제품 가격 인상으로 스마트폰 및 PC 수요는 위축되었지만, 서버 주문이 호조를 보이면서 이러한 공백이 채워질 전망이다. CSP들은 고속 데이터 전송 및 AI 서버 인프라 구축에 필요한 대규모 데이터 저장 용량에 대한 수요 증가로 인해 기업용 SSD 수요가 크게 증가하고 있다. 기존 HDD의 지속적인 공급 부족으로 인해 스토리지 관련 주문이 상당 부분 QLC 기업용 SSD로 전환되었다. 주요 공급업체의 재고 수준은 사상 최저 수준으로 떨어졌고, 생산량은 주문 증가율을 크게 따라가지 못하고 있다. 이러한 급증하는 수요와 제한된 공급 속에서 NAND 플래시 공급업체들의 ASP는 상승 기조를 이어갈 것으로 전망된다.

글로벌 반도체 시장 규모 추이



자료: WSTS, Trendforce, 한국IR협의회 기업리서치센터

글로벌 반도체 부문별 시장 규모 추이



자료: WSTS, Trendforce, 한국IR협의회 기업리서치센터



투자포인트

1 고객사 CAPA 투자로 장비 수요 확대

반도체 고객사 CAPA 확대에 따른 장비 수요 증가 예상

반도체 고객사들의 CAPA 확대에 따른 동사 장비 수요 증가가 예상된다. DRAM 3사 모두 HBM과 범용 DRAM 수요에 대응하기 위한 투자를 확대하고 있다. 클린룸 공간 제약으로 2025년까지는 후공정 투자에 무게가 실렸으나, 2026년 들어서는 신규 클린룸 확보를 통한 전공정 투자가 본격화되고 있다. 삼성전자는 P4, SK하이닉스는 M15X에서 신규투자를, 마이크론은 Fab 16에서 DRAM 전환 투자를 집행 중이다.

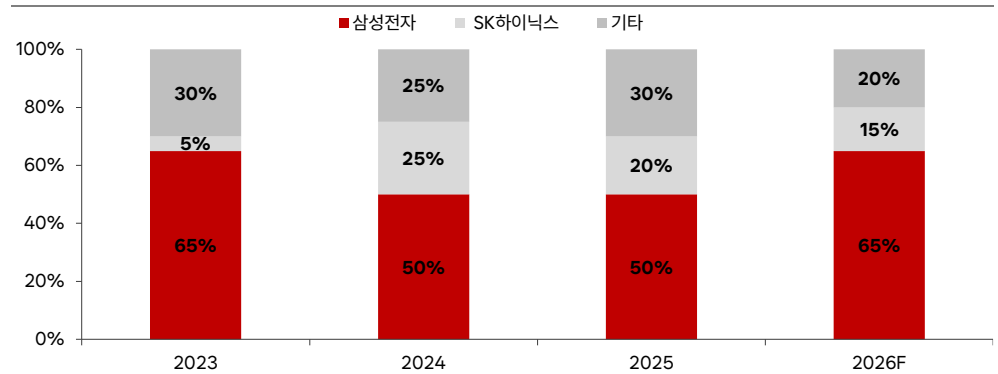
삼성전자 P4는 HBM4 대응을 위한 DRAM 중심 투자로 진행되고 있다. P4 내에서도 Ph3는 2025년 하반기부터 장비 반입이 시작됐고, 이어서 Ph4, Ph2가 순차적으로 입고될 예정이다. SK하이닉스 M15X 역시 4Q25부터 장비 입고가 시작됐으며, 당초 계획 대비 투자 규모가 확대되어 연내 80K/월 수준까지 확대될 전망이다. 한편 2027년에는 장기 수요에 선제 대응하려는 클린룸 CAPA 확보 경쟁이 본격화되며 2026년보다 확대된 장비 수요가 기대된다. 삼성전자 P5, SK하이닉스 Y1Fab, 마이크론 ID1, Tongluo(PSMC P5) 등 신규 팹 투자가 차례로 집행될 것으로 전망된다. NAND는 고단화 전환 투자를 통해 수요 증가에 대응하는 흐름이 이어지고 있다. 다만 삼성전자 P5나 마이크론 싱가포르 신규 Fab과 같은 NAND형 신규 투자는 2028년에야 장비 집행이 이루어질 것으로 예상된다. 비메모리 영역에서는 Intel이 Arizona Fab52에서 18A 공정 중심의 투자를 지속하고 있고, TSMC는 Arizona Fab에 하반기 장비 입고를 앞두고 있으며 대만 내 선단 공정 투자도 이어지고 있다. 삼성전자 파운드리 역시 미국 Taylor Fab에서 하반기 양산용 목표로 설비 투자를 진행 중이다.

동사는 국내 메모리 업체와 미국, 중국 DRAM 업체, Foundry 및 OSAT 업체로 장비를 공급하고 있다. 최종 고객사 기준으로 보면 국내 메모리 업체향 매출 비중은 약 70~80%에 달한다. 동사의 장비는 반도체 고객사들이 선정하여 CVD, Etcher 및 TC Bonder 등의 장비사가 채택하는 구조로 실질적인 고객사는 반도체 업체이다. 따라서 반도체 업체의 CAPA 투자 현황, 특히 메모리 투자가 실적에 가장 큰 영향을 끼친다. 특히 동사는 삼성전자의 EFEM 표준화 공급사로 선정되어 있다. 이에 따라 고객사 EFEM 공급 물량 내에서 높은 점유율을 보이고 있는 만큼 삼성전자의 신규 Fab 투자와 함께 동사 수주도 함께 증가한다.

후공정 매출 비중 확대 배경은 HBM 수요 증가에 따른 TC본더형 EFEM 발주 증가에 기인한다. 동사는 삼성전자와 SK하이닉스의 주요 TC본더 장비사를 1차 고객으로 모두 확보하고 있어 HBM 투자 확대에 따른 수혜 노출도가 크다. 또한 후공정 EFEM은 전공정 대비 포트 수와 로봇 탑재 수가 많아 장비 단가(ASP)가 높고, 이로 인해 후공정 비중 확대가 이익률 개선으로 이어지고 있다.

동사는 2026년 국내 DRAM 업체의 전공정 신규 투자에 이어 하반기에는 HBM 후공정 투자가 집행되는 구간에 진입했고 2027년에는 장기 수요 대응을 위해 앞당겨진 신규 팹 CAPA 투자가 추가로 이어져 이에 따른 장비 수요 증가가 예상된다. 전공정 투자에 이어 후공정 투자도 이어지며 2026~2027년에 걸친 연속적 CAPA 확대로 단기 실적 개선뿐 아니라 중기적인 매출 가시성까지 함께 확보하고 있다고 판단된다.

싸이맥스 고객사 비중



자료: 싸이맥스, 한국IR협의회 기업리서치센터

신규 장비로 신규 고객 확대 기대

VFEM, 제습모듈, Slim EFEM 등 차세대 제품 통한 고객사 확대 기대

동사는 기존 EFEM, CTS, LPM 공급을 넘어, VFEM(Vertical EFEM), 제습모듈(EDM), Slim EFEM 등 차세대 제품을 통해 고객사 확대를 이룰 것으로 기대된다.

제습모듈(EDM, Equipment Dehumidify Module)은 작년부터 매출 인식이 시작되어 올해도 이어지고 있다. 기존에는 EFEM 내부 습도를 낮추기 위해 질소(N₂)를 채우는 방식이 일반적이었으나, 미세 공정화로 질소 사용량 증가에 따른 운영비 부담이 커지면서 회전형 로터(Rotor) 기반 제습 방식이 대안으로 부상했다. 동사는 인입형(풍속 0~0.45m/s 제어로 습도 3% 미만 구현)과 상부거치형(기류 이송 덕트 단열 최적화) 두 가지 형태를 모두 개발해 운영비 절감과 수율 개선을 동시에 충족시키고 있다.

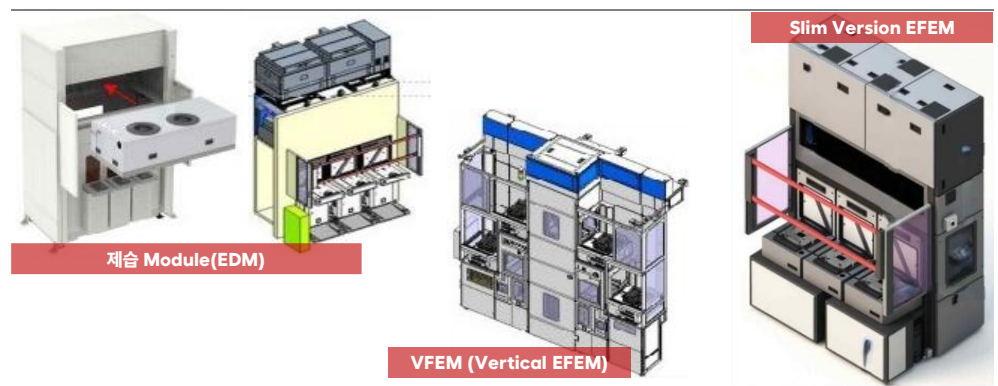
Slim EFEM은 LPM 도어부를 슬림화하면서 확보된 하부 공간에 유지보수용 Bottom Cabinet을 배치했고, 자체 개발 다관절 ATM 로봇에 카메라 모듈을 적용해 웨이퍼 휨(Warp)을 자동 검출하는 동시에 로봇 자가진단 기능을 구현했다. 여기에 EDM을 탑재해 내부 습도를 10% 이내로 관리하고, New Curtain Module로 FOUP 내부 습도 균일화까지 지원한다. 즉 공간 효율, 수율, 습도 개선을 하나의 패키지로 묶은 장비로, 현재 쉼이 진행 중이라 매출 반영까지는 추가 시간이 필요하다.

VFEM(Vertical EFEM)은 기존 EFEM의 수평 배치형 LPM 구조를 수직으로 전환해 Footprint를 줄인 차세대 폼팩터다. 클린룸 공간 비용이 높은 고객사 입장에서 동일 면적 내 더 많은 포트를 확보할 수 있어 설치 공간 축소와 유지보수 시간 단축 효과가 크다. 현재 국내 장비사와는 장비 평가 중이며 국내 고객사 적용 이후 AMAT, LAM, TEL 등 해외 장비 적용을 목표로 하고 있다.

또한 동사는 국내 기판 업체와 유리기판용 EFEM을 개발하여 장비 평가 중이다. 고밀도, 고신뢰성 패키징 수요가 지속 증가하며 실리콘 인터포저 대비 낮은 제조원가 등의 장점으로 유리 소재의 기판 또는 인터포저 도입에 대한 요구는 계속될 것으로 판단된다. 유리기판은 AI 서버를 포함한 HPC용 칩에 적용될 것으로 전망한다. 향후 2027~2028년 유리 기판 시장 개화와 함께 동사 유리기판용 EFEM의 공급도 본격화될 것으로 기대된다.

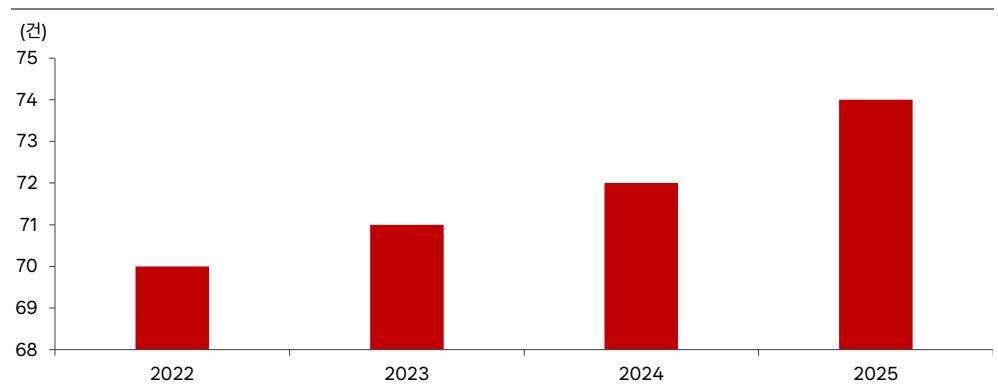
이러한 신제품 개발이 가능한 배경은 동사의 국산화 및 내재화 역량에 있다. 동사 장비 내 ATM 로봇은 과거 외산 제품을 사용하다 자체 개발로 전환해 후공정 장비에는 이미 자사 로봇을 탑재하고 있고, 전공정 장비로도 적용을 확대 중이다. VTM 역시 2021년을 기점으로 국산화를 추진하며 가격 경쟁력을 확보했다. 로봇, VTM, EFEM, LPM을 모두 자체 설계, 생산할 수 있는 수직계열화 역량은 경쟁사와 차별화되는 포인트이다. 또한 R&D 인력이 전체의 30%를 차지하고 특허 누적 건수가 2022년 70건에서 2025년 74건으로 꾸준히 증가하는 등 선행기술 개발에 대한 투자가 신제품 파이프라인으로 이어지고 있다. 제품모듈의 매출 기여가 이미 실적에 반영되고 있는 가운데, Slim EFEM과 VFEM이 순차적으로 쿨을 통과해 해외 장비사로의 공급이 시작되면 동사는 기존 국내 메모리 중심 고객 구조에서 벗어나 고객 다변화에 따른 중장기 성장동력을 추가로 확보할 것으로 판단된다.

싸이맥스 신규 장비



자료: 싸이맥스, 한국IR협회의 기업리서치센터

싸이맥스 누적 특허권



자료: 싸이맥스, 한국IR협회의 기업리서치센터



실적 추이 및 전망

1 후공정 비중 증가 보인 2025년

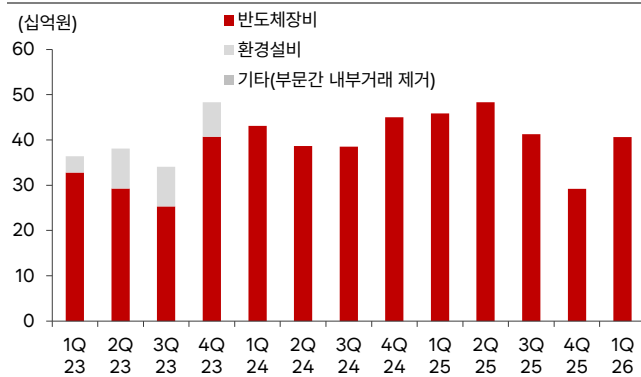
2025년 매출액

1,644억 원(-0.4% YoY),

영업이익 233억 원(-0.3% YoY)

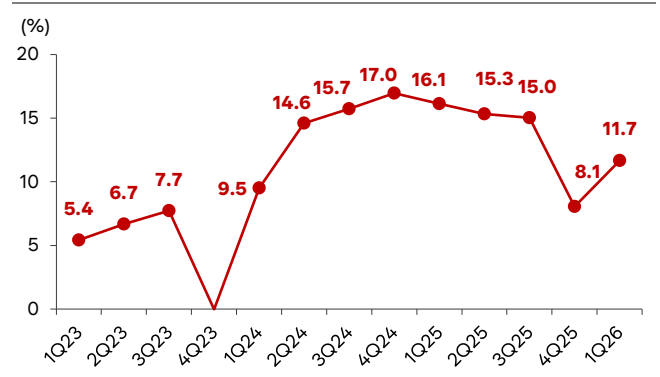
2025년 동사는 매출액 1,644억 원(-0.4% YoY), 영업이익 233억 원(-0.3% YoY)을 기록하였다. 분기별 매출액 흐름을 보면 1Q25 458억 원(OPM 16.1%), 2Q25 483억 원(OPM 15.3%)으로 상반기는 견조했으나, 3Q25 412억 원(OPM 15.0%), 4Q25 291억 원(OPM 8.1%)으로 하반기 들어 매출과 수익성이 동반 둔화됐다. 4Q25는 고객사 장비 공급이 지연된 영향으로 매출액이 크게 감소하였다. End 고객사 매출 비중은 삼성전자 50%, SK하이닉스 20%, 기타 30%를 보였다. 2023년 65% 비중을 차지하였던 삼성전자는 2024년과 2025년 50%대로 매출 비중이 낮아졌으며, 반면 2023년 5%에 불과하던 SK하이닉스 매출 비중은 2024년 25%에 이어 2025년에도 20%로 견조함을 보였다. 이는 삼성전자의 전공정 투자 증가가 제한적인 가운데 HBM 수요 대응을 위한 후공정 투자 확대와 SK하이닉스의 M15X 초기 장비 반입 영향에 기인한다. 이에 따라 후공정 매출 비중도 약 35%로 과거 10% 대비 크게 확대된 것으로 파악된다. 수익성 측면에서는 전년도와 유사한 매출액 규모를 기록함에 따라 OPM도 전년 수준인 14.2%를 기록하였다.

싸이맥스 부문별 매출액 추이



자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

싸이맥스 분기별 영업이익률 추이



자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

2 전공정과 후공정이 동시 성장할 2026년

2026년 매출액

2,321억 원(+41.1% YoY),

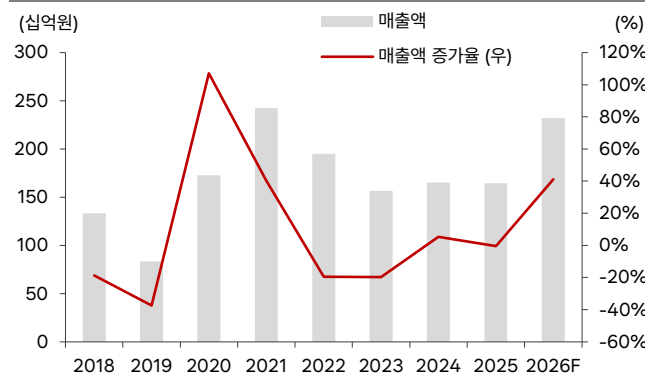
영업이익

356억 원(+52.7% YoY) 전망

2026년 동사의 실적은 매출액 2,321억 원(+41.1% YoY), 영업이익 356억 원(+52.7% YoY)을 전망한다. 1Q26은 매출액 405억 원(-11.6% YoY, +39.3% QoQ), 영업이익 47억 원(-36.0% YoY, +101.7% QoQ)을 기록하였다. 1분기는 4Q25에 지연된 장비 공급이 반영되며 전분기 대비 매출액 성장을 보였다. 연간 실적은 1분기를 저점으로 증가할 것으로 보인다. 2026년 삼성전자의 P4 Ph3, Ph4, Ph2 투자와 SK하이닉스의 M15X 본격 투자로 인해 전공정 장비 매출 성장이 예상된다. 삼성전자의 미국 Taylor Fab 투자도 동사 장비 수요에 긍정적이다. 전공정 투자가 연간 꾸준히 나타날 것으로 보이는 가운데 하반기에는 HBM용 후공정 투자가 더해질 것으로 전망된다. 상대적으로 삼성전자의 투자 강도가 강한 만큼 동사 고객사 비중에서도 삼성전자가 전년 50%에서 2026년에는 65%까지 확대될 것으로 예상된다. 후공정에 있어 동사는 SK하이닉스 밸류체인인 한미반도체, ASMPT, 삼성전자 밸류체인인 세메스 등 주요 TC본더 장비사를 모두 고객으로 확보하고 있어 HBM4 발주 개시 시 수혜가 기대된다. 수익성 측면에서는 장비사 특성상

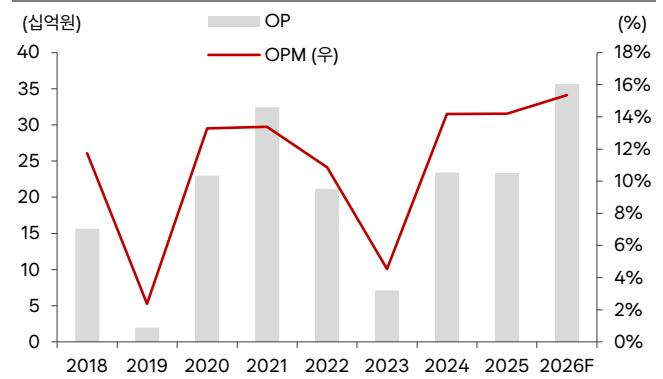
고정비 부담이 일정 수준으로 유지되기 때문에 매출액 규모가 확대됨에 따른 이익률 개선이 예상된다. 또한 후공정 장비의 경우 ATM 로봇 내재화와 EFEM의 포트 수가 많아 단가와 수익성이 전공정 장비 대비 높다. 따라서 후공정 장비 매출액 규모 확대는 이익률에 긍정적 영향을 끼친다. 2026F OPM 15.4%(+1.2%p YoY)를 전망한다.

싸이맥스 매출액 및 매출액 증가율 추이



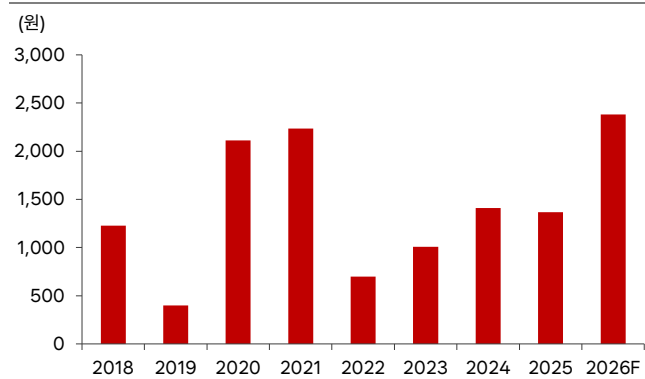
자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

싸이맥스 영업이익 및 영업이익률 추이



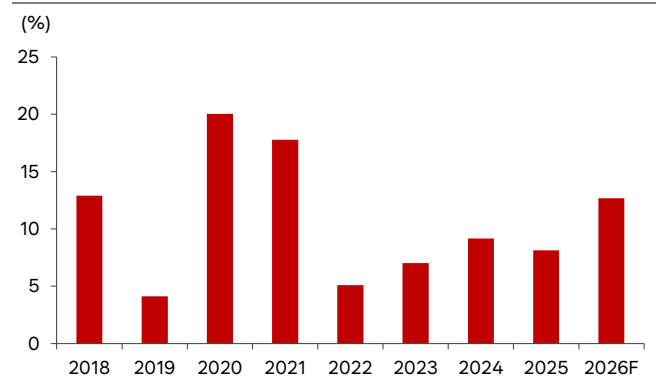
자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

싸이맥스 EPS 추이



자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

싸이맥스 ROE 추이



자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

싸이맥스 부문별 실적

(단위: 십억원)

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2023	2024	2025	2026F
매출액	36.3	38.0	34.0	48.2	43.0	38.6	38.5	45.0	45.8	48.3	41.2	29.1	40.5	156.6	165.1	164.4	232.1
반도체장비	32.8	29.3	25.4	40.7	43.1	38.7	38.5	45.0	45.9	48.4	41.3	29.2	40.6	128.2	165.3	164.7	232.4
환경설비	3.6	8.9	8.7	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.8	-	-	-
기타(부문간 내부거래 제거)	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
영업이익	2.0	2.5	2.6	-0.0	4.1	5.6	6.1	7.6	7.4	7.4	6.2	2.3	4.7	7.1	23.4	23.3	35.6
지배주주순이익	3.9	4.4	2.1	0.6	5.0	3.6	-5.1	11.9	5.6	5.6	4.2	-0.4	4.0	11.0	15.4	14.9	26.0
Margin(%)																	
영업이익률	5.4	6.7	7.7	-0.0	9.5	14.6	15.7	17.0	16.1	15.3	15.0	8.1	11.7	4.5	14.2	14.2	15.4
지배주주순이익률	10.8	11.5	6.1	1.3	11.6	9.4	-13.3	26.5	12.1	11.6	10.2	-1.5	9.8	7.0	9.3	9.1	11.2
YoY Growth(%)																	
매출액	-23.1	-22.6	-41.9	20.0	18.4	1.5	13.1	-6.8	6.5	25.1	7.1	-35.3	-11.6	-19.7	5.4	-0.4	41.1
반도체장비	-20.8	-34.4	-53.5	10.8	31.3	32.2	51.9	10.5	6.5	25.0	7.1	-35.2	-11.5	-27.7	29.0	-0.4	41.1
환경설비	-37.6	52.7	110.4	114.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.3	-100	-	-
기타(부문간 내부거래 제거)	-	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지
영업이익	-68.8	-58.3	-62.6	적전	107.4	122.6	130.3	흑전	80.8	31.5	2.3	-69.2	-36.0	-66.4	229.1	-0.3	52.7
지배주주순이익	-26.6	82.9	-63.5	흑전	27.6	-17.5	적전	1,765	11.4	54.7	흑전	적전	-28.8	44.2	39.9	-3.1	74.2
QoQ Growth(%)																	
매출액	-9.6	4.6	-10.6	41.9	-10.8	-10.2	-0.4	16.9	1.9	5.4	-14.7	-29.4	39.3				
반도체장비	-10.7	-10.8	-13.4	60.6	5.8	-10.2	-0.4	16.8	1.9	5.4	-14.7	-29.3	39.2				
환경설비	2.6	144.2	-1.6	-13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
기타(부문간 내부거래 제거)	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지				
영업이익	13.5	28.5	3.8	적전	흑전	37.9	7.4	26.0	-3.1	0.2	-16.4	-62.1	101.7				
지배주주순이익	흑전	12.3	-52.8	-69.2	680	-27.4	적전	흑전	-53.4	0.9	-24.9	적전	흑전				

자료: Quantwise, 한국IR협회의 기업리서치센터

Valuation
2026F PER 15.2x

메모리 초호황에 따른 투자 확대
수혜, 신규 장비를 통한 해외
장비사로의 공급 가시화 시
Valuation re-rating 가능

동사의 현주가는 2026F PER 15.2x로 Historical PER Band(5.5x~25.0x) 중단에 위치해 있다. Peer 기업으로는 EFEM을 생산하는 국내외 기업을 선정하였다. Peer 업체의 2026F 평균 PER은 21.6x 수준이다. 로체시스템즈는 EFEM, 모바일 로봇 등 웨이퍼 이송 장비를 생산하며 싸이맥스와 가장 경쟁 관계에 있다. 로체시스템즈는 일본 Rorze의 자회사로 기술 및 고객 네트워크에서 글로벌 레퍼런스가 있는 점이 장점이다. 다만 디스플레이 매출 비중이 48%로 반도체 45% 대비 높고 컨센서스가 부재하여 직접적인 Valuation 비교는 어렵다. 라온로보틱스(2026F PER 21.4x)는 웨이퍼 이송 로봇과 이송 모듈을 생산한다. 라온로보틱스는 매출 규모가 작고 수익성도 낮다. 그럼에도 불구하고 기술 장벽이 높은 VTM 로봇을 생산하고 해외 고객사로 공급 확대 기대감으로 상대적으로 높은 Valuation에 거래되고 있다고 판단된다. Hirata(2026F PER 14.9x)는 EFEM, LPM, ATM 로봇 등을 생산한다. 반도체향 매출 비중이 38~46%를 차지하나 차량용 매출 비중이 37~46%를 보이며 EV 시장 불확실성과 상대적으로 낮은 수익성이 Valuation 디스카운트 요소로 작용하고 있다. Rorze(2026F PER 28.7x)는 글로벌 EFEM 시장 점유율 1위 업체로 반도체 매출 비중은 83%이다. 특정 고객사에 의존하지 않고 TSMC, 삼성전자, SK하이닉스, Micron, Intel 등 글로벌 고객을 보유하고 있으며 영업이익률 20%대로 높은 수익성을 유지한다. 높은 수익성, 시장 지배력 등이 Valuation 프리미엄의 이유라 판단한다.

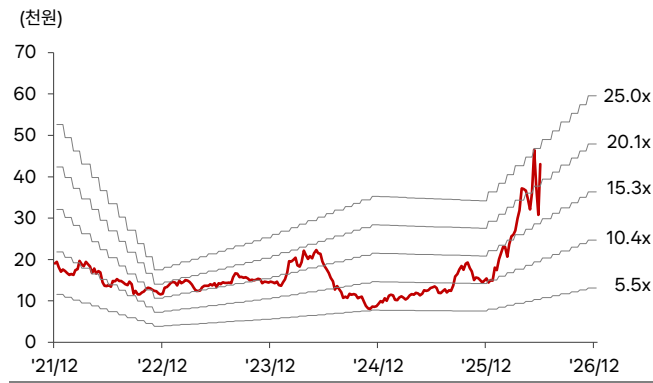
동사는 국내 메모리 업체 의존도가 높고 상대적으로 낮은 수익성이 Rorze 대비 낮은 Valuation을 받는 이유다. 다만 메모리 초호황 속 높은 메모리 고객 의존도가 오히려 현재 메모리 투자 확대 사이클에서는 수혜 요인으로 작용할 수 있고 신규 장비를 통해 향후 해외 장비사로의 공급이 가시화되면 Valuation re-rating 여지도 있다고 판단된다.

동종 업종 밸류에이션

기업명	종가 (원, 달러)	시가총액 (십억원, 백만달러)	매출액(십억원, 백만달러)			PER(배)			PBR(배)		
			2024	2025	2026F	2024	2025	2026F	2024	2025	2026F
코스피	8,051	6,389,602	3,712,325	3,917,205	4,030,707	11.3	15.4	8.4	0.8	1.3	2.0
코스닥	847	475,908	332,661	361,183	129,613	211.4	112.5	25.3	1.5	2.1	3.0
싸이맥스	36,300	397	165	164	232	6.0	10.7	15.2	0.5	0.8	1.8
로체시스템즈	6,870	105	160	125	-	22.3	11.0	-	2.2	1.0	-
라온로보틱스	9,440	125	49	54	62	14.9	49.4	21.4	2.3	4.9	3.0
Hirata	19	624	554	637	597	20.9	10.5	14.9	0.8	1.0	1.2
Rorze	29	5,187	824	820	946	11.1	19.6	28.7	2.3	3.0	5.5
동종업종 평균						17.3	22.6	21.6	1.9	2.5	3.2

주: 1) 2026년 07월 06일 종가 기준. 동종그룹 26F는 시장 컨센서스 사용, 2) 라온로보틱스 26F는 당사 추정치 사용, 3) 로체시스템즈는 26F 컨센서스 없음, 4) Hirata, Rorze는 CY 기준
자료: FnGuide QuantWise, Refinitiv, 한국IR협회의 기업리서치센터

싸이맥스 PER Band



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

싸이맥스 PBR Band



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

리스크 요인
1 높은 국내 메모리 고객사 비중

**높은 메모리 고객사 비중으로
반도체 CAPA 투자 조정 발생 시
즉각적인 영향 발생 가능**

2026F End user 비중 기준 삼성전자 65%, SK하이닉스 15%로 국내 메모리 2사 합산 비중이 80%에 달한다. 국내 메모리 업체의 투자 속도 조절이나 CAPA 투자 지연이 발생하면 실적에 직접적으로 타격이 온다. 2023년 전공정 투자 위축으로 동사의 수익성이 급감한 사례가 이를 잘 보여준다. 동사는 장비사 인도 시점에 매출을 인식하며 리드타임이 최대 2개월로 짧아 고객사 발주 사이클이 분기 실적에 바로 반영되는 구조로, 업황 둔화 시 실적 하락이 빠르게 나타난다. 차기 HBM 퀵테스트 지연 재현, AI 투자 심리 위축에 따른 글로벌 반도체 CAPA 투자 조정 등이 발생하면 실적에 즉각적인 영향이 발생할 가능성이 있을 것으로 예상된다.

포괄손익계산서

(억원)	2022	2023	2024	2025	2026F
매출액	1,951	1,566	1,651	1,644	2,321
증가율(%)	-19.5	-19.7	5.4	-0.4	41.1
매출원가	1,568	1,342	1,253	1,231	1,775
매출원가율(%)	80.4	85.7	75.9	74.9	76.5
매출총이익	382	224	397	413	545
매출이익률(%)	19.6	14.3	24.1	25.1	23.5
판매관리비	171	153	163	180	189
판매관리비율(%)	8.8	9.8	9.9	10.9	8.1
EBITDA	240	99	259	259	382
EBITDA 이익률(%)	12.3	6.3	15.7	15.7	16.5
증가율(%)	-32.1	-58.5	160.9	-0.2	47.6
영업이익	212	71	234	233	356
영업이익률(%)	10.8	4.5	14.2	14.2	15.4
증가율(%)	-34.7	-66.4	229.1	-0.3	52.7
영업외손익	-113	81	-48	-60	-26
금융수익	33	58	141	26	30
금융비용	113	20	199	92	62
기타영업외손익	-33	43	9	5	5
총속/관계기업관련손익	-3	-3	-15	4	4
세전계속사업이익	96	149	171	177	334
증가율(%)	-69.3	56.0	14.7	3.2	88.8
법인세비용	18	31	17	27	73
계속사업이익	78	118	154	149	260
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	78	118	154	149	260
당기순이익률(%)	4.0	7.6	9.3	9.1	11.2
증가율(%)	-67.7	51.5	30.3	-3.1	74.2
지배주주지분 순이익	76	110	154	149	260

현금흐름표

(억원)	2022	2023	2024	2025	2026F
영업활동으로인한현금흐름	-6	276	123	437	181
당기순이익	78	118	154	149	260
유형자산 상각비	26	28	25	24	25
무형자산 상각비	2	0	0	1	0
외환손익	6	1	0	1	0
운전자본의감소(증가)	-237	131	-185	191	-145
기타	119	-2	129	71	41
투자활동으로인한현금흐름	-448	239	3	95	-146
투자자산의 감소(증가)	-44	-173	85	102	-57
유형자산의 감소	0	0	0	0	0
유형자산의 증가(CAPEX)	-30	-5	-20	-8	-20
기타	-374	417	-62	1	-69
재무활동으로인한현금흐름	119	-332	-68	-99	-41
차입금의 증가(감소)	173	-297	-30	-150	3
사채의증가(감소)	0	0	0	0	0
자본의 증가	0	0	0	0	0
배당금	-41	-31	-36	-36	-44
기타	-13	-4	-2	87	0
기타현금흐름	-3	-0	8	0	-3
현금의증가(감소)	-339	182	65	432	-8
기초현금	552	213	395	461	893
기말현금	213	395	461	893	885

재무상태표

(억원)	2022	2023	2024	2025	2026F
유동자산	1,481	1,282	1,296	1,415	1,755
현금성자산	213	395	461	893	885
단기투자자산	666	312	70	68	96
매출채권	194	247	435	228	387
재고자산	373	312	314	218	376
기타유동자산	34	16	16	9	13
비유동자산	780	844	978	825	880
유형자산	368	309	314	290	285
무형자산	31	31	31	35	35
투자자산	255	398	446	289	349
기타비유동자산	126	106	187	211	211
자산총계	2,260	2,126	2,274	2,240	2,635
유동부채	700	484	506	283	456
단기차입금	385	100	70	0	0
매입채무	122	207	228	148	265
기타유동부채	193	177	208	135	191
비유동부채	20	17	31	15	21
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0
기타비유동부채	20	17	31	15	21
부채총계	720	501	537	298	476
자배주주지분	1,513	1,625	1,737	1,942	2,159
자본금	55	55	55	55	55
자본잉여금	548	548	548	556	556
자본조정 등	-80	-80	-80	0	0
기타포괄이익누계액	-1	-0	0	0	0
이익잉여금	991	1,102	1,213	1,331	1,548
자본총계	1,541	1,625	1,737	1,942	2,159

주요투자지표

	2022	2023	2024	2025	2026F
P/E(배)	16.6	14.3	6.0	10.7	15.2
P/B(배)	0.8	1.0	0.5	0.8	1.8
P/S(배)	0.6	1.0	0.6	1.0	1.7
EV/EBITDA(배)	3.8	10.6	2.2	2.5	7.8
배당수익률(%)	2.6	2.4	4.1	2.7	1.1
EPS(원)	699	1,008	1,411	1,368	2,382
BPS(원)	13,851	14,877	15,898	17,779	19,761
SPS(원)	17,855	14,338	15,109	15,050	21,242
DPS(원)	300	350	350	400	400
수익성(%)					
ROE	5.1	7.0	9.2	8.1	12.7
ROA	3.5	5.4	7.0	6.6	10.7
ROIC	22.8	9.0	27.9	26.5	47.1
안정성(%)					
유동비율	211.6	264.7	256.0	500.6	385.4
부채비율	46.7	30.8	30.9	15.3	22.1
순차입금비율	-24.9	-32.1	-21.4	-49.0	-44.9
이자보상배율	22.9	4.9	41.8	70.3	910.8
활동성(%)					
총자산회전율	0.9	0.7	0.8	0.7	1.0
매출채권회전율	11.1	7.1	4.8	5.0	7.6
재고자산회전율	5.7	4.6	5.3	6.2	7.8

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다. 시장경보제도는 '투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목'의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.

※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의 7

종목명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
싸이맥스	O	X	X

2026년 6월 15일 기준 투자경고 지정예고에 따른 투자주의종목으로 지정된 바 있음.

발간 History

발간일	제목
2026.07.08	싸이맥스-전공정 재개, 후공정은 지속
2022.04.15	싸이맥스-반도체 이송 장비 업체, 2022년은 상저하고

Compliance notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회 산하 독립 (리서치) 조직인 기업리서치센터가 작성한 기업분석 보고서입니다. 본 자료는 투자자들에게 국내 상장기업에 대한 양질의 투자정보 제공 및 건전한 투자문화 정착을 위해 무상으로 작성되었습니다.

- 당사 리서치센터는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트와 그 배우자 등 관계자는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 중 소형 기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- 본 자료에 게재된 내용은 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 자료제공일 현재 시점의 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생될 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다.
- 본 조사자료는 투자 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료는 텔레그램에서 "한국IR협의회(<https://t.me/kirsofficial>)" 채널을 추가하시어 보고서 발간 소식을 안내받을 수 있습니다.
- 한국IR협의회가 운영하는 유튜브 채널 'IRTV'에서 1) 애널리스트가 직접 취재한 기업탐방으로 CEO인터뷰 등이 있는 '小中한탐방'과 2) 기업보고서 심층해설방송인 '小中한 리포트 가치보기'를 보실 수 있습니다.